

2.5D[®]

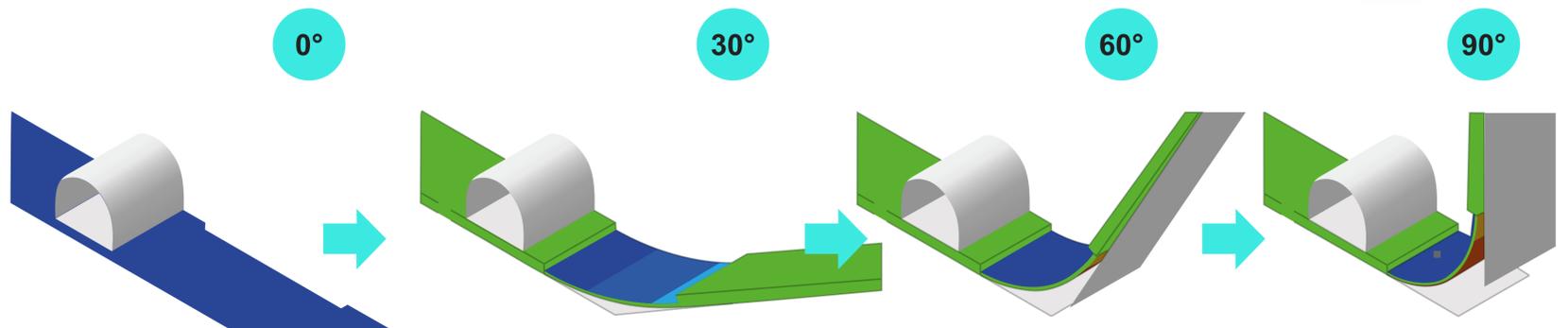
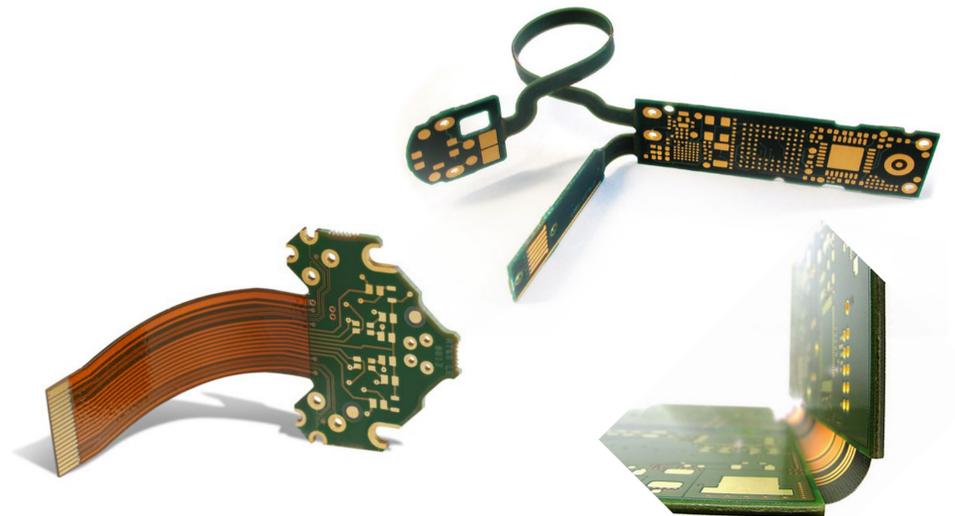
放熱、シールド、モジュール化、及び
シグナルインテグリティを改善できる
キャビティテクノロジー

Thank you for visiting
the AT&S booth.
Visit ats.net for more
information.



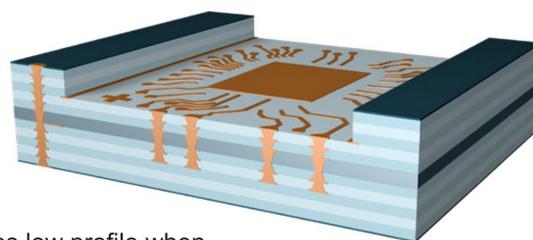
2.5D[®] Rigid-Flexible 2.5D[®] リジッドフレキ

- A new alternative to rigid-flexible substrate
- Can be handled with normal FR-4 material / No material restrictions
- High voltage design available
- Optimal bending achieved through stress simulation
- リジッドフレキ基板の代わりに新たな提案
- 通常FR-4材にて対応可能/材料制限なし
- 高電圧デザイン対応可能
- 応力シミュレーションにて最適な折り曲げを実現

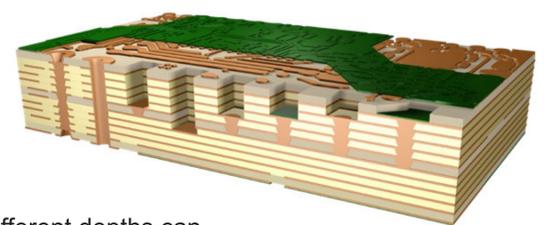


2.5D[®] Cavity 2.5D[®] キャビティ

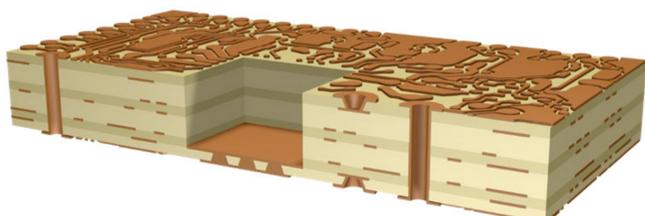
- Components can be mounted in cavity
- Cavity surface treatment possible
- Can apply resist in cavity
- Cavity shape, depth and number are not limited
- キャビティ内実装可能
- キャビティ内表面処理可能
- キャビティ内レジスト塗布可能
- キャビティの形状・深さ・数に制限なし



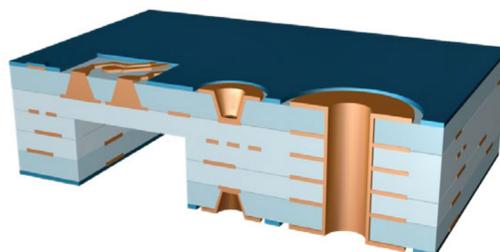
Achieves low profile when
mounting components
部品実装時の低背化を実現



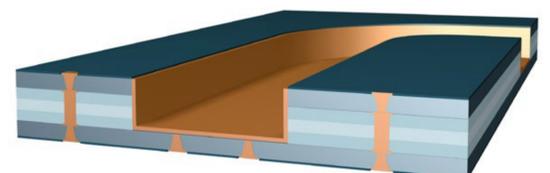
Cavities with different depths can
be created on the same substrate
同一基板内に深さの異なる
キャビティの作成が可能



Reduced thermal
resistance
放熱経路短縮による
熱抵抗の低減



Improved signal
characteristics
信号特性の改善



Cavities provide excellent
EM-shielding
キャビティは優れた電氣的
シールド効果を実現